

Micron의 하이브리드 메모리 큐브(HMC) 차세대 슈퍼컴퓨터

분야에서 찬사 이어져

신형 Micron 장치, 페타 크기의 슈퍼컴퓨팅 지원

메모리 장벽을 뛰어넘어 슈퍼컴퓨터의

난제 해결

2013년 11월 8일, 아이다호 보이시 (Globe Newswire) -- Micron Technology, Inc.(Nasdaq:MU)는 오늘, 슈퍼컴퓨터 시스템에 맞는 자사의 하이브리드 메모 큐브(HMC)를 통해 메모리 기술을 한 차원 높일 계획이라고 밝혔다. HMC는 메모리에 저에너지의 고대역폭 접속이 필요한 용도를 위해 설계되었으며, 슈퍼컴퓨터에 필요한 요구사항 중 가장 중요한 것이다. 다른 용도로는 데이터 패킷 처리, 데이터 패킷 버퍼링 또는 스토리지, 그리고 프로세서 가속이 있다.

Micron과 슈퍼컴퓨팅 분야의 글로벌 리더인 Fujitsu(후지쓰)는 11월 19일부터 21일까지 덴버에서 열리는 2013 슈퍼컴퓨팅 대회(Supercomputing '13 Conference)에서 후지쓰의 차세대 슈퍼컴퓨터 프로토타입에 탑재된 HMC 디바이스를 중심으로 디스플레이 보드를 전시할 예정이다.

슈퍼컴퓨팅은 과학자 및 엔지니어들이 연구 개발을 수행하면서 복잡한 시뮬레이션을 반복해야 하는 필수 기술이며, 이를 통해 우주의 형성 원리에 관한 근본적인 질문을 탐구할 수 있다. 이런 엄청난 주제를 다루려면, 굉장한 양의 데이터를 움직일 수 있어야 한다. HMC를 사용하여 슈퍼컴퓨터의 멀티코어 프로세서 기술이 지닌 잠재성이 실현된다면, 성능 효율이 전례없이 증가할 것이다.

Micron의 DRAM Solutions Group 담당 부사장인 Brian Shirley는 "후지쓰의 디자이너 및 엔지니어들은 HMC를 사용하여 시스템을 한 차원 높일 수 있다는 점을 일찍부터 알고 있었습니다"라고 말했다. 그는 "우리는 후지쓰가 가장 진보된 컴퓨팅 문제에 도전할 수 있는 역량을 즉시 키울 수 있길 바랍니다."라고 덧붙였다.

후지쯔의 차세대 기술 컴퓨팅 팀장인 유지 오이나가는 "당사의 시스템 디자이너들이 HMC에 매료된 것은 HMC가 대역폭, 초소형 폼팩터 그리고 최적화된 비트 당 에너지에 대해 늘어나는 수요를 지원하는 새로운 메모리 시스템 설계를 가능하게 하기 때문입니다"라고 말했다. 그는 "애플리케이션 소프트웨어의 성능 효율을 최적화하려면, B/F(바이트/플롭) 비율을 반드시 개선해야 하는데 HMC는 슈퍼컴퓨팅용 메모리 성능의 새로운 표준을 대변하고 있습니다"라고 덧붙였다.

업계의 돌파구가 될 HMC는 고급 TSV(through-silicon vias: 개별 칩을 쌓아 올려서 전기적으로 연결하는 전선관)를 사용하여 Micron의 최첨단 DRAM에 고성능의 로직을 결합한다. Micron의 HMC는 초당 160GB라는 놀라운 메모리 대역폭을 제공하는 동시에, 기존의 기술을 활용할 때보다 비트 당 최대 70%의 에너지를 절감하여 고객들의 총소유비용(TCO)이 크게 낮아진다.

업계의 리더들과 영향력 있는 인사들은 HMC야말로 DRAM의 성능 개선 속도와 프로세서의 데이터 소모율 간 격차를 줄일 수 있다고 오래 전부터 인정하고 있다. 최근, Micron의 HMC는 업계의 전자제품 전문 매체인 EDN과 EE Times로부터 올해의 메모리 제품으로 선정되었다.

Micron은 2014년 하반기에 2GB 및 4GB HMC 장치를 대량 생산할 계획이다.

Micron 소개

Micron Technology, Inc.는 첨단 반도체 솔루션을 제공하는 세계 선두 업체 중 하나로, 전세계적으로 최첨단 기술의 컴퓨팅 제품 및 소비재 제품, 네트워킹 제품, 내장 제품 및 휴대용 제품에 사용되는 획기적인 메모리 기술 및 패키징 솔루션과 반도체 시스템은 물론 모든 종류의 DRAM, NAND Flash 및 NOR Flash 메모리를 제조 및 판매하고 있다. Micron의 보통주는 NASDAQ에서 MU라는 약어로 거래되고 있다. Micron Technology, Inc에 대한 자세한 정보는 www.micron.com를 참조한다.

(C)2013 Micron Technology, Inc. All rights reserved. 정보는 고지 없이 변경될 수 있습니다. "Micron" 및 Micron 케도 로고는 Micron Technology, Inc의 등록상표입니다. 기타 모든 상표는 각 소유자의 자산입니다. 이 보도자료에는 HMC(Hybrid Memory Cube)의 샘플 가용성 및 대량 생산에 관한 전향적인 진술이 포함되어 있습니다. 실제 이벤트 또는 결과는 전향적 진술로

예측된 이벤트 또는 결과와 크게 다를 수 있습니다. Micron 이 미국 증권거래위원회
간헐적으로 통합 제출하는 문서들, 특히 Micron 에서 최근 제출한 Form 10-K 및 Form 10-Q 를
참조하십시오. 이 문서들은 Micron 의 실질적인 결과가 통합 기반으로 당사의 전향적인 진술에
포함된 결과와 크게 달라질 수 있는 중요 요인들을 파악한 것입니다 (특수 요인 참고). 당사에서
전향적 진술에 반영된 예상치가 적절하다고 판단하더라도, 향후의 결과, 활동 수준, 성과 또는
목표를 보장할 수는 없습니다.

연락처: Micron Media Contact:

Scott Stevens

+1-512-288-4050

sstevens@micron.com